

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和7年6月23日(2025.6.23)

【公開番号】特開2024-49897(P2024-49897A)

【公開日】令和6年4月10日(2024.4.10)

【年通号数】公開公報(特許)2024-066

【出願番号】特願2022-156409(P2022-156409)

【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 3 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)

C 1 1 D 7 / 3 2 (2 0 0 6 . 0 1)

C 1 1 D 7 / 5 0 (2 0 0 6 . 0 1)

C 1 1 D 7 / 2 6 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【F I】

H 0 1 L 2 1 / 3 0 4 6 4 7 A

C 1 1 D 7 / 3 2

C 1 1 D 7 / 5 0

C 1 1 D 7 / 2 6

【手続補正書】

20

【提出日】令和7年6月13日(2025.6.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第四級アンモニウム水酸化物(成分A)、アミノアルコール(成分B)、溶剤(成分C)、尿素(成分D)及び水(成分E)を含有し、成分Eの含有量が50質量%以上である、樹脂マスク剥離用洗浄剤組成物。

30

【請求項2】

成分Cは、芳香族アルコール、グリコールエーテル及び芳香族ケトンから選ばれる少なくとも1種である、請求項1に記載の洗浄剤組成物。

【請求項3】

成分Cは、ベンジルアルコールである、請求項1に記載の洗浄剤組成物。

【請求項4】

前記洗浄剤組成物中の成分Eの含有量が65質量%以上である、請求項1に記載の洗浄剤組成物。

【請求項5】

40

請求項1から4のいずれかに記載の洗浄剤組成物を用いて、樹脂マスクが付着した被洗浄物から樹脂マスクを剥離する工程を含む、洗浄方法。

【請求項6】

請求項1から4のいずれかに記載の洗浄剤組成物を用いて、樹脂マスクを有する電子回路基板を洗浄する工程を含む、電子部品の製造方法。

50